

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2025 年 10 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）		
参与单位名称	10 月 31 日 中金公司 国信证券 华泰证券 瑞银证券 华创证券 东北证券 上海证券 浦银国际证券 建银国际证券 中信期货 昆仑健康保险 君义振华管理 华为投资 江苏天骏投资 北京中泽控股 深圳丞毅投资 华方私募基金 上海尚颀投资 海南鸿盛私募 中信证券 中国银河证券 华福证券 国联民生证券 华西证券 山西证券 高盛(亚洲) 美银证券 宝盈基金 国华人寿保险 晋江乾集私募 浦赢建和资产 上海度势投资 山东驼铃私募 上海呈瑞投资 上海沃霖资产 上海嘉世私募 上海博笃投资 上海孝庸资产 广发证券 兴业证券 开源证券 东方证券 摩根大通证券 中国国际金融证券 摩根士丹利 瑞穗证券亚洲 花旗环球金融 永安财产保险 国华兴益保险 上海申银万国证券 北京泰德圣私募 上海行知创业投资 博众智能科技投资 广西赢舟管理咨询 吕梁小金地资产 前海大千华严投资 前海诚域私募		

	北京星允投资 北京金安私募 北京高熵资产 上海益和源 玄卜投资 上海盛宇 广东邦政资产 秋阳予梁投资 IGWT Investment	上海明泫投资 深圳市尚诚资产 耕零(上海)投资 上海合道资产 上海伯兄资产 北京弘峰投资 深圳市红石榴 泽恩投资控股	上海秋阳予梁投资 江西省杜兹投资 广州市航长投资 上海丰仓股权投资 北京涇谷私募基金 广州瑞民私募证券 埃普斯国际 Pleiad Investment
时间	10 月 31 日		
地点	无锡		
上市公司接待人员姓名	何小龙 华润微电子董事长 吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘		
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事长致辞 报告期内，公司累计实现营收 80.69 亿元，同比增长 7.99%；归母净利润 5.26 亿元，同比增长 5.25%，核心财务指标保持稳健增长。第三季度单季实现营收 28.51 亿元，同比增长 5.14%，归母净利润 1.87 亿元，同比略有下降，主要受四大重点项目处于高折旧阶段的影响。产品与方案板块延续良好增势，营收占比提升至 55%。重点产品方面，MOSFET、IGBT、SiC 及 IPM 等核心产品实现高速增长，展现出强劲的产品竞争力。 公司重点推进的四大项目进展顺利，重庆 12 吋项目于第三季度实现投料与产出双达 3 万片，良率行业领先。深圳 12 吋项目持续推进 90、55、40nm 等多技术节点产能建设，月产能已达 1 万片。先进功率封测基地项目产能利用率持续维持在 80%以上，优于去年同期。高端掩模项目聚焦 90nm 及以下高端节点，今明两年将逐步拓展至 55nm、40nm，一期产能累计 4500 片/月。 公司围绕新能源汽车与人工智能加速产品布局。新能源汽车		

领域，提供覆盖动力总成与电压转换系统的完整解决方案。人工智能方向，重点布局 AI 服务器与数据中心基础设施，并积极把握汽车智能化机遇。此外，在 AI 端侧应用方面加快落地，覆盖具身智能、人形机器人及工业自动化等前沿领域，形成多层次、高成长性的业务布局。

二、投资者的主要问题

问题一：请问公司如何看待功率行业的涨价？

答：公司对部分 IGBT 产品实施了价格上调，主要基于两方面原因：一是为应对铜等原材料成本上涨的压力；二是相关领域订单表现良好。目前市场对此次价格调整接受度较高，此次调价本身释放出积极信号，表明在经历近两年的价格下行周期后，功率器件市场已进入企稳向好的新阶段。

问题二：请问公司认为目前处于周期什么位置，行业头部厂商稼动率偏满是否有可能部分产品价格做一些修复？

答：目前行业整体处于筑底过程中的温和复苏阶段。尽管头部厂商产能利用率处于较高水平，但仍处于临界状态，尚未达对客户全面提价的程度，未来价格走势仍取决于需求端的进一步增长。

问题三：储能的经济性逐步显现且大储渗透率加速，请问对公司业务有多大拉动作用？

答：公司在储能领域的订单增长明确且具备持续性。凭借 MOSFET、IGBT、SIC、模块等多品类产品组合，公司可同时覆盖小储与大储市场需求，并已在部分大储项目中实现产品导入或批量供应。目前，公司正积极推动更多产品进入大储产业链，对储能市场特别是大储领域的未来发展持乐观态度。

问题四：公司能否按各应用领域的景气度进行拆解分析？

答：从产品与方案业务板块来看，储能和光伏领域增长最为明显，合计营收占比已达 25%；家电行业表现预计四季度环比提升，目前占比约 20%；汽车市场保持稳健增长；工业与通信设备领域（包含数据中心、AI 服务器等）也实现良好增长，占比约 18%。总体来看，上述几大重点市场均为公司持续看好且具备增长潜力的方向。

问题五：请问公司深圳 12 吋项目客户拓展情况？

答：深圳 12 吋项目主要聚焦大客户开发，目前已与多家重点客户达成深度合作意向，项目涵盖 PMIC、显示驱动、存储驱动等关键品类，后续订单储备足以支撑产能爬坡节奏。

问题六：请问公司 BCD 代工的产能利用率情况？未来在产能扩建方面是否会专注于模拟相关？

答：BCD 工艺作为公司特色工艺平台之一，目前产能利用率饱满，6 吋及 8 吋产线均处于满载状态。公司已于两年前布局深圳 12 吋产线，其中包括 90nm BCD 工艺，旨在实现对现有 8 吋 BCD 工艺的升级，相关技术布局已全面展开。后续将视新建产线的运行及产能利用情况而定，适时评估进一步扩产的可能性。

问题七：在 BCD 领域国内仍存在较为激烈的竞争环境，请问公司如何采取差异化策略？

答：公司在 BCD 工艺领域具备多项核心优势：一是拥有深厚技术积累与长期工艺沉淀；二是实现从 6 吋、8 吋到 12 吋 BCD 工艺的全方位布局，可满足客户多样化需求并支持产品升级；三是具备从晶圆制造到封装测试的一站式服务能力，尤其在模拟芯片封装方面配套完整。因此，公司在技术广度、工艺平台完整性和服务能力方面具备显著竞争优势。

问题八：请问公司三季度产能稼动率情况？

答：晶圆制造方面，6 吋、8 吋及重庆 12 吋均保持满载运行。封装测试方面，今年整体均保持在 80%以上，特别是三季度以来进一步提升至 90%左右，同比显著优于去年同期水平。

问题九：请问公司三季度毛利率环比改善的原因？

答：毛利率的改善主要得益于两方面：一是产能利用率持续处于高位，这是影响毛利率和成本最敏感的因素，也是毛利率提升的基本前提。二是产品结构的调整，公司将有限产能优先配置于高附加值产品，提升了整体产品组合的盈利水平。此次毛利率改善主要来自产品结构优化，而非直接调价。

问题十：请问公司在第三代半导体 SiC、GaN 方面的进展？

答：公司第三代半导体保持高速增长，其中碳化硅产品方面，主驱及辅驱模块均已批量，产线基本满产，且在手订单充裕，8 吋产品已出样在客户端验证，主要面向工控大功率电源、数字服务器电源等领域。氮化镓产品方面，主要布局 6 吋 D-MODE 平台及 8 吋 E-mode 平台。

问题十一：友商宣布新建 12 吋产线，公司是否也会考虑新的资本支出项目？

答：公司当前正全力推进四个大项目的产能爬坡与满产达成，今明两年的资本开支将重点投向产能的弹性建设与技术的提升。未来，公司也规划在现有产线达到既定产能利用率后，通过自建、并购或战略投资等方式适时扩充产能。从目前各厂区预留物理空间及公司现金流储备来看，已具备后续稳健扩产的资源条件，为中长期发展留出了充足弹性。

	问题十二：公司在 AI 领域的布局有哪些？ 答：公司积极把握 AI 产业发展机遇，重点布局四大业务方向：一是为 AI 服务器与数据中心提供高性能功率器件解决方案；二是面向汽车智能化转型，布局智能驾驶与智能座舱相关产品。三是推进 AI 在端侧应用的落地，涵盖 AI 手机、AI PC 及智能穿戴设备等领域。四是积极拓展具身智能场景，包括工业机器人、人形机器人及自动化系统。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月